

檔 號：

保存年限：

朝陽科技大學 函

地址：413310臺中市霧峰區吉峰東路
168號

承辦人：劉惠盈

電話：04-23323000#7572

傳真：04-23742371

電子郵件：hyliu@cyut.edu.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年3月10日

發文字號：朝理工字第1100000578號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本校與國際電機電子工程師學會(IEEE)於110年7月23日至25日於本校舉辦第4屆知識創新與發明國際研討會(IEEE ICKII 2021)，請惠予公告於貴校官網並鼓勵所屬師生踴躍投稿，請查照。

說明：

- 一、本研討會徵稿領域為工程及知識創新相關領域，摘要投稿截止日期為110年5月31日，研討會相關訊息請詳見IEEE ICKII 2021研討會官網：<http://www.ickii.org>。
- 二、本研討會接受之論文，若符合IEEE領域，將收錄於IEEE Xplore®，並於Ei Compendex索引。其他領域之論文將送至Scopus和CPCI審核後索引。優秀論文可推薦轉投到12種SCI或SSCI期刊。

正本：各公私立大專校院

副本：本校理工學院